

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2025 年 6 月 18 日-6 月 26 日)

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐专场机构交流会 ☐其他 _____ ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐现场参观
参与单位名称及人员姓名	Jefferies Jacky He、Jefferies Kelly Zou、Goldman Sachs Asset Management Leo Lin、Pinpoint Asset Management David Ni、Oberweis Asset Management Fangwen Zhou、国海证券 高力洋、农银汇理 张璋、纽富斯投资 戚锦锭、兴全基金 张荣朗沐、兴全基金 叶飞、中泰证券 康丽侠、申万宏源 李天奇、山东鲁商基金 阚泽昌、广发证券 李学涛、世纪证券 李时樟、平安证券 窦泽云、招商证券 吴彤、国联基金 陈祖睿、江苏瑞华 王革、诚朴资产 乔磊、摩根士丹利基金 李子扬、广发证券 焦鼎
会议时间	2025 年 6 月 18 日 13: 30-14: 30 2025 年 6 月 18 日 16: 30-17: 30 2025 年 6 月 19 日 13: 00-14: 00 2025 年 6 月 23 日 16: 00-17: 00 2025 年 6 月 26 日 15: 30-16: 30
会议地点	佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	Q1. 公司有哪些产品可以满足 AI 时代的高性能存储产品需求？ A1: 公司在 AI 端侧领域的产品线布局以高性能存储技术为核心，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、具身智能等多场景。公司面向 AI 手机已推出 UFS、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已量产 12GB、16GB 等大容量 LPDDR5X 产品。公司面向 AI PC 已推出高端 DDR5 超频内存条、PCIe 5.0 SSD 等高性能存储产品。在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被应用于智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备上。此外，公司在 AI 教育、AI 翻译等 AI 端侧领域布局行业领先。2024 年公司 AI 新兴端侧领域营收超过 10 亿元，同比增长约 294%。在企业级领域，公司面向 AI 服务器打造了完善的企业级存储解决方案，已推出 CXL 内存、PCIe SSD、SATA SSD、及 RDIMM 内存条等产品线，其中，公司企业级 SP506/516 系列 PCIe5.0 SSD 荣获了存储风云榜“2024 年度企业级固态硬盘产品金奖”。 Q2. 能否介绍公司在 AI 眼镜产品方面的客户合作和收入情况？ A2: 在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已进入 Google、Meta、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等知名企业的供应链体系，其中，公司为 Ray-Ban Meta

	提供 ROM+RAM 存储器芯片，是国内的主力供应商。2024 年公司面向 AI 眼镜产品收入约 1.06 亿元，预计 2025 年公司面向 AI 眼镜产品收入有望同比增长超过 500%。 Q3. 公司晶圆级先进封测项目的最新进展如何？可满足哪些应用需求？ A3：公司晶圆级先进封测项目正在建设中，预计将于 2025 年下半年投产。公司晶圆级先进封测项目将覆盖 Chiplet、RDL、Fanout、SiP 等多种先进封装形式，以满足先进 DRAM 存储器、先进 NAND 存储器、存储与计算整合等领域的发展需求。 Q4. 公司目前在智能汽车领域可以做哪些产品，解决方案竞争力如何体现？未来车规存储放量进度如何预期？ A4：公司已经推出了车规级 eMMC、LPDDR、NOR Flash 等产品，可广泛应用于辅助驾驶系统、智能网联汽车、车载无人机及其他高端智能设备，为智能车机和智能驾驶技术的创新与发展提供了强有力的数据存储支持。公司在车规级嵌入式存储领域具备显著技术优势，能够提供采用佰维自研主控芯片的全国产化方案，进一步增强了产品的自主可控性与技术竞争力，并通过自有先进封装和测试制造体系，严格控制生产工艺，确保产品能够在极端环境下稳定运行，满足车规标准。同时，公司能够为不同客户提供量身定制的存储解决方案，进一步巩固了在车规细分市场中的竞争优势，并确保在不断变化的市场环境中始终保持技术领先地位。在车规领域，公司产品已在国内头部车企及其 Tier1 供应商量产。未来公司将不断扩展车规存储品类，提升产品市占率。 Q5. 存算一体产业趋势对公司的价值体现在哪里？公司有哪些布局？ A5：存算一体是未来大的产业趋势，在很多场景下，系统厂商或大的设计厂商需要与合作伙伴协同开发存算一体解决方案，例如将逻辑单元与存储合并，可使芯片尺寸更小、功耗更低，提升边缘计算性能和客户体验。比如在自动驾驶的应用场景，客户需要定制化适配和成本可接受的方案，解决方案厂商能从中找到商业机会。公司积极推进与 IC 设计厂商、晶圆制造厂商以及终端客户等产业链伙伴的合作。针对边缘推理芯片、AI 手机、智能驾驶、AR/VR 等领域的存力需求，公司技术团队正在开发多种存算合封技术方案和先进存储芯片技术方案，覆盖了 Chiplet、RDL、Fanout、SiP 等多种先进封装形式，能够为客户提供整套的存储+晶圆级先进封装测试综合解决方案。 Q6. 目前看到公司在 AI 端侧存储领域具有明显的先发优势，其背后的核心驱动力是什么？ A6：AI 端侧场景要求存储产品具有高性能、低功耗的特性，过去的存储产品主要通过固件来优化性能，未来要通过主控芯片设计、固件算法与先进封装能力实现差异化竞争。在主控芯片设计方面，公司积极布局芯片研发与设计领域，将采用业界领先的架构设计，提升公司在 AI 手机、AI 穿戴、AI 智驾等领域的高端存储解决方案的产品竞争力；在固件算法方面，公司全面掌握了存储固件核心技术，有能力匹配各类客户典型应用场景，为客户提供创新、优质的存储解决方案；在先进封装方面，公司已掌握 16 层叠 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平，并构建 Bumping、RDL、
--	---

	Fanout 等晶圆级先进封装能力。通过主控芯片设计、固件算法与先进封装的协同效应，公司的存储解决方案实现行业领先的产品创新能力和可靠性，能够持续为终端客户提供适合 AI 端侧场景的高性能、低功耗的存储器产品。 Q7. 公司第一款主控芯片量产节奏如何？未来有哪些发展规划，如何适配下游终端应用？ A7：公司首款主控芯片 SP1800 eMMC 5.1 实现多项国产突破，已成功量产，性能优异，目前已送样国内某头部客户，实测关键指标性能和功耗满足客户需求。在智能穿戴应用方面，SP1800 在性能和功耗方面进行了优化，并可实现定制化调整，其解决方案受核心客户认可；在手机应用方面，SP1800 支持 TLC 及 QLC 颗粒，迎合手机存储 QLC 替代趋势，其解决方案将于 2025 年量产；在车规应用方面，SP1800 提供端到端数据保护，适合车规宽温应用场景，其解决方案受核心客户认可。公司在芯片设计领域持续加大研发力度，专注于自研 LDPC 纠错算法、高性能架构以及低功耗技术的研发，致力于构建主控核心技术平台。基于该平台，公司积极推进 UFS 主控芯片等关键领域，围绕功耗、性能、可靠性等核心指标，努力打造行业领先的、具备高度竞争力的主控能力，为提升存储解决方案的核心竞争力提供坚实保障。 Q8. 作为业内领先的存储解决方案商，公司如何看待存储行业未来发展趋势并有哪些相关布局？ A8：我们认为存储行业未来有三个发展趋势。一是在云、边、端三个方面的 AI 深度应用。AI 要求存储具有大容量和高带宽的特点，边缘、端侧更强调存储低延迟、高性能和小尺寸，因此需在芯片设计、先进封装、测试设备等多个技术领域适应 AI 时代，做出满足更大容量、更高性能、更低功耗、更小尺寸综合要求的产品，通过差异化的解决方案提升方案价值。公司在 AI 端侧存储拥有较强的竞争力，主要得益于研发封测一体化布局，公司在主控芯片设计、解决方案研发和先进封测等领域的技术能力行业领先，可为 AI 端侧产品提供低功耗、高性能、小尺寸、大容量的存储解决方案；二是全球贸易摩擦使市场割裂，更加强调本地化交付能力，公司积极进行区域产能布局，在国内、巴西、印度、墨西哥等地布局，能够为公司带来新商业机会。三是存储与先进封装深度整合，先进封装成为技术前进的主要方向，公司能为终端客户和芯片设计厂商提供一站式解决方案，相较于提供单一的存储解决方案或者先进封测服务，具备综合的竞争力；公司提供的综合解决方案的价值量相比单独的先进封测服务，具有显著的放大效应，可以在 AI 时代持续创造价值。
附件清单	无
日期	2025 年 6 月 18 日-6 月 26 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。